

1	2	3	4			
		수 정 내 용				
		부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
		1	도면 양식 변경	손윤희	최영호	2003. 1. 8.
ST						
ST(기초)						
ST(개선)						

10	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	DSR01043-N/1
9	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00102-5/1
8	BACK NUT	1	MBsBD	Silver Plate	DBN00119-5/1
7	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01042-N/1
6	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00119-N/1
5	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00118-N/1
4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00054-N/1
3	CONTACT	1	MBsBD	Silver Plate	DCT01111-5/1
2	CONTACT	1	MBsBD	Silver Plate	DCT01110-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Silver Plate	DBD01461-5/1

대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차		년월일		2002. 5. 3.			
소수		승인					
각도		검도					
분수		제도					
재질		도면		7/16"DIN-P3-1 5/8"			
열처리		작성부서		연 구 소			
보호파막처리		적도		NS	단위	mm	중량

 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		A4		도면		CN00741-7/1	
						K318-085-000	